

欣旺达电子股份有限公司

关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月22日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

因公司经营和业务发展需要，公司拟以位于深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧欣旺达新能源产业基地厂房A、B、C及宿舍楼（粤2016深圳市不动产权第0155021号）作为抵押，向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度。公司将根据自身运营的实际需求确定具体授信额度的使用。公司授权董事长全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

截止2018年10月22日，本次抵押资产的合计账面价值为368,436,065.77元，占公司最近一期经审计净资产的11.75%。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2018年10月22日